

平成15年度事業報告書

自:平成15年4月1日 至:平成16年3月31日

1. 全般

今年度は賛助会員会費の収入減(大口会員の口数減)による学会財務状況の改善のために、以下の重点施策を実施し、会員増強と財務改善に対する見通しを得た。

- 1) 各種事業の場において機会ある毎に学会のPRに努め、魅力ある学会とするために、技術委員会、研究会の活動を活発に行うと共に、調査・研究成果の情報発信を強化した。また、エレクトロニクス実装学会誌の質と量を向上させるべく投稿規定を改定した。
- 2) 会員各位のご協力を支えに新規会員勧誘を推進して、正会員数は過去最高の水準に達した。更に12月に設立した関西支部を拠点とする西日本地区会員増強体制を確立した。正会員数は過去最高の2,859名に達した。
- 3) 大会、教育事業の運営努力による事業収入の向上並びに事務局費の節減で財務の健全化を図った。

2. 国際会議・学術講演大会・展示会等の開催(定款第4条第1号関係)

(1)国際会議「2003 ICEP」の開催

IEEE CPMT Japan Chapter と共催で第7回目の国際会議を4月16日～18日の3日間、第一ホテル東京シーフォートにおいて開催。

「アジア発の新しい実装技術の波」をテーマに海外26件を含む94件の論文発表(一般発表92, セッション招待2)。国際交流会開催。優秀論文賞5件と若き発表者への賞3件を表彰。

論文集(A4判・512頁)。参加者数326名(内、海外41名)。

(2)2003 マイクロエレクトロニクスショー(2003ME Show)の開催

4月16日～18日、「最先端実装技術・パッケージング展」と称して、東京流通センターにおいて開催。

出展社数55社、79小間、製品技術セミナー参加社数22社・聴講者数1,954名、「実装研究セミナー」参加者数424名、展示会来場者数12,026名。

(3)第18回エレクトロニクス実装学術講演大会の開催

3月17日～19日の3日間、東京都目黒区の東京工業大学大岡山キャンパスにおいて開催。特別講演1件、依頼講演16件・一般講演107件で計124件の講演発表が行われた。

論文集(A4判・244頁)。参加登録者数819名。

(4)先端技術セミナーの開催

第33回定例セミナー

「ユビキタス社会を支えるモバイル機器実装最前線」をテーマに7月8日、東京・国立オリンピック記念青少年総合センターで開催。

講演件数6件。参加者数149名。

第34回定例セミナー

「車載用エレクトロニクス技術動向」をテーマに11月11日、東京・国立オリンピック記念青少年総合センターで開催。

講演件数6件。参加者数170名。

第35回定例セミナー

「次世代を担うナノテク応用の回路形成技術動向」をテーマに1月21日、東京・国立オリンピック記念青少年総合センターで開催。

講演件数7件。参加者数195名。

JIEP 九州セミナー

「低温鉛フリーはんだ実装技術と実用化の現状」をテーマに 11 月 14 日、北九州・アジア太平洋インポートマートで開催。

講演件数 6 件。参加者数 79 名。

(5)第 13 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム(MES2003)の開催

10 月 16 日～17 日、大阪府吹田市・大阪大学コンベンションセンターにおいて開催。103 件の論文発表(一般発表 101, 招待講演 2)が行われた。

論文集(A4 判, 419 頁)発行。参加者数 607 名。

(6)第 1 回関西支部見学会 / 技術講演会の開催

16 年 2 月 6 日、兵庫県加古川市のハリマ化成・加古川製造所で、技術講演会と同製造所見学会を開催。参加者数 72 名。

3 . 調査・研究活動(定款第 4 条第 2 号関係)

(1)ワークショップの開催

2003 ワークショップ(修善寺)の開催

9 月 4 日～5 日の 1 泊 2 日で、ラフォーレ修善寺ホテル棟において開催。「IT・ネットワーク社会を先取りする先進実装」をメインテーマとし、サブテーマに“製品力・製造力の強化を目指して”と題し、31 件の発表(ポスターセッション)と 2 件の特別講演。参加者数 94 名。

関西ワークショップ 2003 の開催

11 月 28 日、京都府中京区、コープ・イン・京都において開催。「実装革命、飛躍の兆し」をテーマに、16 件の発表(ポスターセッション)と講演 1 件。参加者数 110 名。

(2)技術委員会の開催事業

材料技術委員会公開研究会の開催

- ・ 10 月 29 日：国立オリンピック記念青少年総合センター
“システムインパッケージと材料動向” 講演 8 件 参加者数 110 名

電磁特性技術委員会サマーセミナーの開催

- ・ 8 月 29 日：国立オリンピック記念青少年総合センター
“高速差動伝送と EMC 実装評価” 講演 8 件 参加者数 187 名

半導体パッケージ技術委員会公開研究会の開催

- ・ 1 月 30 日：学会会議室
“SIP を実現するキイテクノロジーと課題” 講演 6 件 参加者数 67 名

(3)公開研究会の開催

低熱膨張材料研究会

- ・ 2 月 26 日：回路会館
“実装材料技術の最前線” 講演 6 件 参加者数 110 名

電磁特性研究会

- ・ 7 月 25 日：機械振興会館
電子情報通信学会 EMC J と共催、講演 16 件 参加者数 120 名

- ・ 11 月 11 日：拓殖大学
講演 5 件 参加者数 38 名

超高速高周波エレクトロニクス実装研究会

- ・ 5 月 30 日：回路会館
講演 7 件 参加者数 43 名

- ・ 8月22日：回路会館
講演 6件 参加者数 81名
 - ・ 11月28日：回路会館
講演 5件 参加者数 49名
 - ・ 15年2月27日：回路会館
講演 7件 参加者数 62名
- 先進実装技術研究会
- ・ 7月15日：回路会館
講演 4件 参加者数 78名
 - ・ 11月10日：回路会館
講演 8件 参加者数 103名
 - ・ 11月21日：国立オリンピック記念青少年総合センター
電子部品研究会と共催
講演 5件 参加者数 96名
 - ・ 横浜国立大学実装技術懇談会と共催
16年1月20日：横浜国立大学共同研究推進センター
講演 5件 参加者数 52名
16年3月16日：横浜国立大学教育文化ホール
講演 7件・ポスターセッション発表 18件 参加者数 127名
- 光回路実装技術研究会
- ・ 5月22日：回路会館
講演 4件 参加者数 66名
 - ・ 9月16日：回路会館
講演 7件 参加者数 117名
 - ・ 11月20日：回路会館
講演 4件 参加者数 51名
 - ・ 16年1月13日：回路会館
講演 4件 参加者数 40名
- システム実装CAE研究会
- ・ 11月19日：回路会館
“ものづくりCAEの問題点を探る” 講演 7件 参加者数 53名
- マイクロファブ리케이션研究会
- ・ 5月23日：回路会館
“金属ナノ粒子を用いたマイクロファブ리케이션”
講演 5件 参加者数 127名
 - ・ 9月26日：回路会館
“日本のモノ作りを支えるマイクロファブ리케이션”
講演 6件 参加者数 100名
 - ・ 12月11日：回路会館
“環境対応のマイクロファブ리케이션技術”
講演 6件 参加者数 114名
- ビルドアップ配線板研究会
- ・ 7月24日：国立オリンピック記念青少年総合センター

“ 先端実装を支える配線板技術の将来像 ”

講演 7 件 参加者数 96 名

回路基板ロードマップ研究会

・ 16 年 3 月 1 日：回路会館

“ 実装技術分野の海外ロードマップの研究 ”

講演 5 件 参加者数 117 名

イオンマイグレーション試験方法研究会

・ 12 月 9 日：国立オリンピック記念青少年総合センター

“ H A S T による加速劣化試験結果とその課題 ”

講演 4 件 参加者数 139 名

微細部品成形・実装技術研究会

・ 7 月 9 日：東京大学先端科学技術研究センター

講演 2 件 参加者数 30 名

・ 9 月 5 日：天満研修センター

講演 1 件 参加者数 83 名

・ 11 月 4 日：東北大学青葉記念会館

講演 3 件 参加者数 42 名

・ 12 月 22 日：東京大学山上会館

講演 4 件 参加者数 18 名

・ 16 年 1 月 9 日：産業技術総合研究所つくば東事業所

講演 3 件 参加者数 17 名

4 . 普及・啓発活動(定款第 4 条第 3 号関係)

(1)教育講座「実装技術入門講座」

5 月 15 日～16 日 学会地下会議室 受講者数 25 名

(2)PWB 製造技術講座

・ 入門コース

6 月 26 日～27 日 国立オリンピック記念青少年総合センター 受講者数 22 名

・ 中級コース

7 月 17 日～18 日 国立オリンピック記念青少年総合センター 受講者数 30 名

(3)実装技術総合講座

10 月 24 日～25 日 国立オリンピック記念青少年総合センター 受講者 19 名

(4)技能検定設計実技講習会

11 月 26 日～27 日 学会会議室 受講者 19 名

5 . 情報収集及び提供活動(定款第 4 条第 4 号関係)

(1)「エレクトロニクス実装学会誌」の発行

Vol.6-No.3～7, Vol.7-No.1～2 の計 7 冊を発行。内, Vol.6-No.5 は臨時増刊。総頁数 640 頁。

(2)海外の技術情報を提供

6 . 内外機関等との交流・協力活動(定款第 4 条第 5 号関係)

(1) アジア連絡委員会設立準備会議の開催

4月17日(I C E P開催2日目), アジアを中心に海外から参加の各国代表者とアジア連絡委員会設立に向けて骨子を話し合った。

(2) 国際シンポジウム「EcoDesign2003」開催に協力

12月10日～12日, 国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて開催された, エコデザイン学会連合主催の標記シンポジウムの実施・運営に協力。

(3)2003JPCA ショー開催を後援

6月4日～6日, 東京ビッグサイトにおいて開催の2003JPCA ショーを後援した。

(4)関連学協会の各種事業に協賛

【協賛】

1.化学工学会

シンポジウム「MEMS と高密度実装の接点を探る」8月6日 東京工業大学

2.電子情報通信学会集積回路研究専門委員会

「第7回システムLSIワークショップ」15年11月25日～27日 北九州国際会議場

3.腐食防食協会

「第33回技術セミナー」9月4日 東京工業大学

「第34回技術セミナー」16年2月20日 東京工業大学

4. 日本時計学会

「2003年秋季マイクロメカトロニクス学術講演会」9月10日 学士会分館

5.溶接学会

「Mate 2004」16年2月5日～6日 パシフィコ横浜

6.色材協会

「色材IT講座」11月28日 東京理科大学

7.アジア南太平洋設計自動化会議 2004

「ASP-DAC 2004」16年1月27日～30日 パシフィコ横浜

7. その他

(1)関西支部の設立

12月1日に関西支部を設立した。

* 16年3月31日現在 会員数

正会員 2,856名(前年同期比167名増)

学生会員 108名(前年同期比17名増)

賛助会員 225社(前年同期比1社減)